07.2

Теплоотводящие электроизолирующие платы для фотоэлектрических преобразователей концентрированного солнечного излучения

© Н.Ю. Давидюк, А.В. Андреева, Д.А. Малевский, П.В. Покровский, Н.А. Садчиков, А.В. Чекалин , В.М. Андреев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

Поступило в Редакцию 10 февраля 2020 г. В окончательной редакции 10 февраля 2020 г. Принято к публикации 11 февраля 2020 г.

Представлены результаты исследований характеристик теплоотводящих электроизолирующих плат разной конструкции, изготовленных на основе теплопроводящих керамик AlN и Al_2O_3 , а также алюмооксидных плат на базе алюминиевых пластин. Теплофизические параметры теплоотводящих плат оценивались путем измерения температуры p-n-переходов фотоэлектрических преобразователей, установленных на платы, при подаче на них тепловой нагрузки. Установлено, что минимальные значения температуры перегрева p-n-переходов 45° С при подводимой тепловой мощности, равной 13 W, наблюдались при их монтаже на керамику AlN. Величина перегрева p-n-переходов при монтаже на керамику Al_2O_3 составила 49° С, а при монтаже на алюмооксидное основание — порядка 70° С.

Ключевые слова: солнечные элементы, p-n-переход, измерение температуры, материал теплоотводов, концентраторные фотоэлектрические преобразователи, тепловые характеристики.

DOI: 10.21883/PJTF.2020.09.49369.18239

Во многих областях силовой электроники при работе электронных компонентов с высоким уровнем тепловыделения ставится задача эффективного отвода тепла с помощью теплоотводящих электроизолирующих плат [1]. Известно, что эффективность преобразования солнечного излучения в электроэнергию, в том числе в концентраторных фотоэлектрических модулях (КФЭМ), уменьшается с увеличением температуры p-n-переходов фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) [2]. В КФЭМ для эффективного отвода тепла от ФЭП и обеспечения электроизоляции при установке нескольких ФЭП на электрогенерирующих панелях модулей могут также эффективно использоваться электроизолирующие теплоотводящие платы.

Выявление тепловых характеристик теплоотводящих плат может осуществляться путем измерения температуры p-n-переходов фотоэлектрических преобразователей при подаче на $\Phi \Pi$ определенной тепловой нагрузки. В настоящей работе проведены исследования эффективности отвода тепла от $\Phi \Pi$ при использовании теплоотводящих электроизолирующих плат разной конструкции.

Разработанный для экспериментов КФЭМ включает линзу Френеля размером $12 \times 12\,\mathrm{cm}$ и электрогенерирующую панель, включающую основание из алюминия размером $14 \times 14\,\mathrm{cm}$ с платой, закрепляемой в центре основания с помощью теплопроводящей пасты "Overcool TC-200" с теплопроводностью $3.8\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$. На верхнюю поверхность платы в ее центре напаивался ФЭП размером $5.5 \times 6\,\mathrm{mm}$.

Были исследованы четыре типа теплоотводящих электроизолирующих плат: два типа плат на основе керамик

AlN и Al_2O_3 и два типа алюмооксидных плат на основе алюминиевых пластин разного размера с диэлектрическими слоями оксида алюминия. На рис. 1 представлены конструкции плат с указанием материалов и толщин слоев плат.

Исследование тепловых характеристик образцов ФЭП на платах в натурных условиях при облучении концентрированным солнечным излучением затруднено, поскольку условия измерения не являются стабильными вследствие изменений как интенсивности освещения, так и условий теплоотвода, зависящих от направления и скорости ветра [3]. Поэтому исследования теплофизических

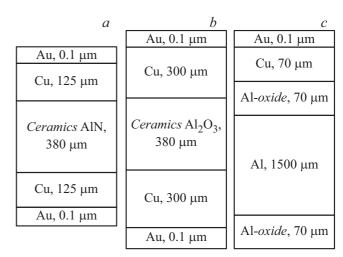


Рис. 1. Структуры теплоотводящих электроизолирующих плат на основе керамики AlN (a) и Al₂O₃ (b) и пластин с диэлектрическими слоями оксида алюминия (c).

F-mail: chekalin@mail.ioffe.ru

характеристик теплоотводящих плат осуществлялись в помещении в затемненных условиях.

Была использована методика определения величины перегрева p-n-перехода $\Phi \ni \Pi$ относительно комнатной температуры при пропускании прямого тока [4]. При этом индикатором температуры $\Phi \ni \Pi$ служили значения прямого падения напряжения на p-n-переходе [5].

Согласно разработанной методике, исследуемый КФЭМ с установленной теплоотводящей электроизолирующей платой и напаянным фотопреобразователем был помещен в термостат, температура в котором менялась от комнатной до 100° С. При разных фиксированных значениях температуры термостата были измерены вольтамперные характеристики ФЭП при подаче тока в режиме одиночных импульсов длительностью $200\,\mu$ s, после чего были рассчитаны значения температурного коэффициента β изменения напряжения на p-n-переходе при заданной плотности тока для исследуемых ФЭП.

Затем при комнатной температуре через контакты исследуемого Φ ЭП пропускался постоянный ток в прямом направлении. При этом выделяемая в p-n-переходе электрическая мощность приводила к разогреву Φ ЭП. По истечении времени, необходимого для перехода всей системы в стационарное температурное состояние, производилось размыкание контактов с помощью электронного коммутатора и за время уменьшения тока до нуля осуществлялась регистрация вольт-амперной характеристики Φ ЭП в разогретом состоянии.

Расчет перегрева (ΔT) p-n-переходов относительно температуры окружающей среды для разных значений плотности тока осуществлялся по формуле

$$\Delta T_{p-n} = \frac{V_{hot} - V_{amb}}{\beta \cdot 10^{-3}},$$

где β [-mV/K] — температурный коэффициент изменения напряжения на p-n-переходе при заданной плотности тока; V_{hot} [V] и V_{amb} [V] — значения напряжений на p-n-переходе при установившейся температуре в нагретом состоянии и при температуре окружающей среды соответственно.

На рис. 2 приведены температурные характеристики четырех образцов $\Phi \ni \Pi$, напаянных на теплоотводящие электроизолирующие платы четырех разных конструкций: две платы размером 2.2×2.2 ст на основе теплопроводящих керамик (зависимости I и 2) и две алюмооксидные платы разного размера 3×3 ст (зависимость 3) и 5×5 ст (зависимость 4).

Как видно из приведенных на рис. 2 зависимостей, наименьшие температуры перегрева p-n-переходов ФЭП наблюдались при их напайке на теплоотводящие платы на основе керамик AlN и Al₂O₃. При подводимой электрической мощности 13 W перегрев ФЭП на этих платах составлял $\Delta T = 43-49^{\circ}$ С. Относительно низкая эффективность отвода тепла в алюмооксидных платах ($\Delta T = 68-71^{\circ}$ С) может быть объяснена высокой пористостью и низкой теплопроводностью оксидных слоев на верхней и нижней поверхностях алюминиевой пластины.

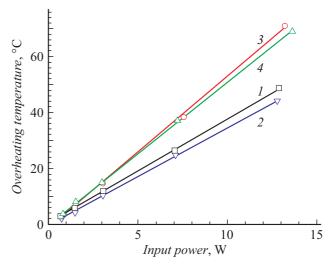


Рис. 2. Зависимость температуры перегрева фотоэлементов от мощности нагрева Φ ЭП, напаянных на теплоотводящие электроизолирующие платы. 1,2 — на основе теплопроводящих керамик Al_2O_3 и AlN соответственно, 3,4 — алюмооксидные платы размером 3×3 и 5×5 cm соответственно.

При мощности прямого солнечного излучения $850~\mathrm{W/m^2}$ линза Френеля с КПД 85% размером $12\times12~\mathrm{cm}$ фокусирует на поверхность ФЭП излучение мощностью $10.4~\mathrm{W}$. Концентраторный модуль на основе каскадного ФЭП GaInP/GaAs/Ge имеет КПД $\sim 30\%$. При такой эффективности существенная часть (30%) тепловой мощности (P_t) излучения, падающего на поверхность ФЭП, отводится в полезную нагрузку, а остальная часть ($P_t\approx7~\mathrm{W}$) превращается в тепло, которое необходимо максимально эффективно отвести от ФЭП. Как видно из рис. 2, перегрев ΔT фотоэлектрических преобразователей при такой тепловой мощности составляет $\Delta T\approx25^\circ\mathrm{C}$ при использовании теплоотводящих плат на основе керамик $\mathrm{Al_2O_3}$ и AlN и $\Delta T\approx36^\circ\mathrm{C}$ при использовании алюмооксидных плат.

На рис. З представлены расчетные распределения температуры вдоль поверхности электрогенерирующих панелей, включающих ФЭП и плату, размещенную в центре алюминиевого основания: с алюмооксидной теплоотводящей платой (рис. 1, c и рис. 3, распределение I) и с платой на основе керамики Al_2O_3 (рис. 1, b и рис. 3, распределение 2). В расчетах были использованы следующие исходные параметры: температура окружающей среды 25° C; выделяемая в ФЭП тепловая мощность $P_t = 7$ W; теплопроводность меди $390 \, \text{W/(m} \cdot \text{K)}$; теплопроводность керамики $Al_2O_3 \, 30 \, \text{W/(m} \cdot \text{K)}$. Температуры крайних точек алюминиевого основания, введенные в расчет, были измерены с помощью терморезисторов.

Типичное значение относительного коэффициента температурного снижения КПД концентраторных фотоэлектрических модулей (с КПД $\sim 30\%$ при 25°C) на основе каскадных ФЭП составляет $K_t \approx -0.074\%/\mathrm{K}$ [6]

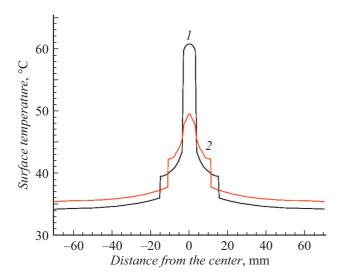


Рис. 3. Расчетные распределения температуры вдоль поверхности двух электрогенерирующих сборок $\Phi \ni \Pi +$ плата + Аlоснование размером 12×12 cm с теплопроводящими платами двух типов: алюмооксидная плата размером 3×3 cm (1) и плата размером 2.2×2.2 cm на основе керамики Al_2O_3 (2).

при кратности концентрирования солнечного излучения, равной 500 "солнц". При величине перегрева $\Delta T=30-45^{\circ}\mathrm{C}$ фотоэлектрического преобразователя в КФЭМ с разработанными теплоотводящими платами снижение КПД фотоэлектрического модуля за счет разогрева составляет величину порядка 1%.

Таким образом, использование в качестве электроизолирующих плат как керамик AlN и Al_2O_3 , так и алюмооксида обеспечивает эффективный отвод тепла, выделяющегося в каскадном Φ ЭП, расположенном в фокусе линзы Френеля размером 12×12 cm.

Финансирование работы

Исследование выполено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-79-30035).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] *Бечтлофф У., Фихлер Р., Шауэр Й., Шмидер К. //* Технологии в электронной промышленности. 2005. № 3. С. 22–24.
- [2] *Rumyantsev V.D.* Terrestrial concentrator PV systems // Concentrator photovoltaics. Springer Ser. in Optical Sciences. 2016. V. 130. P. 151–174.
- [3] Núñez R., Antón I., Askins S., Sala G., Araki K. // AIP Conf. Proc. 2014. V. 1616. P. 144–148.
- [4] Rumyantsev V.D., Davidyuk N.Yu., Chekalin A.V., Malevskiy D.A., Pan'chak A.N., Sadchikov N.A., Andreev V.M., Luque A. // IEEE J. Photovolt. 2015. V. 5. N 6. P. 1715–1721.

- [5] Kinsey G.S., Hebert P., Barbour K.E., Krut D.D., Cotal H.L., Sherif R.A. // Prog. Photovolt.: Res. Appl. 2008. V. 16. N 6. P. 503–508.
- [6] Siefer G., Bett A.W. // Prog. Photovolt.: Res. Appl. 2014. V. 22. N 5. P. 515–524.